FED

Wir verbinden

33. FED-Konferenz

24./25. September 2025
Lübeck

Starke Verbindungen

Design, Fertigung und Management im Dialog

Jetzt Konferenz-App nutzen

almit Technology for the future · Altium · ANS Answer Elektronik GmbH Core of SMT & THT · Becker Müller · beflex A Company of Kontron · CSK CAD Systeme Kluwetasch · Felder seit 1979 Löttechnik

FlowCAD · Geyer quartz technology · ILFA WE CARE FOR CONNECTIONS · Koh Young Europe · Kraus Hardware GmbH · peters Coating Innovations for Electronics · Optimize your Supply Chain powered by Perzeptron

Alba PCB Group · Q-Print The PCB Company · Richter Leiterplatten · Siemens · SGCircuits PCB Group for excellent customer solutions · Würth Elektronik More than you expect · Zuken

Zuversichtlich in die Zukunft

Gemeinsam die Elektronik von morgen gestalten

Ich freue mich sehr, Sie zur 33. FED-Konferenz nach Lübeck einladen zu dürfen.
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, technologischer Umbrüche und wachsender globaler Herausforderungen ist es umso wichtiger, den Austausch innerhalb unserer Branche zu stärken.

Die Konferenz bietet Ihnen eine wertvolle Gelegenheit, neue Perspektiven zu gewinnen, voneinander zu lernen und sich mit engagierten Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen. Der FED schafft als Brücke zwischen Elektronikentwicklung, -design, -fertigung und der Zuliefererindustrie Räume für Begegnung, Wissenstransfer und kreative Lösungsansätze.

Lassen Sie uns gemeinsam nach vorn schauen, Ideen teilen und Zuversicht stärken. Unsere Branche lebt vom Miteinander, von Offenheit und dem Mut, Neues zu wagen. Ich lade Sie herzlich ein, sich aktiv einzubringen, voneinander zu lernen und gemeinsam Lösungen für die Elektronik von morgen zu gestalten.

Ihr Dieter Müller
Vorstandsvorsitzender des FED

Keynotes

MI | 24.09. | 08:45 UHR

Nich lang snacken – man maken!
Manfred Garz

Manfred Garz ist Gründer aus Leidenschaft. Nach seinem Rückzug aus der von ihm mit gegründeten Firma Garz & Fricke betreut er als Investor und Business Angel vielversprechende Startups in Norddeutschland.

Auf seine typische Art erzählt der gebürtige Hamburger von seinen Gründertätigkeiten in der Elektronikbranche, was er dabei gelernt hat und wo er die Herausforderungen der heutigen Zeit sieht. Was ihn nervt, ist das ständige Rufen nach dem Staat. Für ihn lohnt sich Gründen immer noch – gerade in einer Zeit des Umbruchs und der Disruptionen. Anhand von konkreten Beispielen zeigt er, wie nicht reden, sondern das konsequente „Selber machen" letztendlich zum Erfolg führt.

DO | 25.09. | 08:35 UHR

KI – Mensch gegen Maschine
Dr. Henning Beck

Irgendwann steht der Menschheit ein Tag bevor, an dem alle technischen Errungenschaften in den Schatten gestellt werden. Der Tag, an dem Künstliche Intelligenz den Menschen überflügelt und die kognitive Vormachtstellung an sich reißt. Wer wird dann obsiegen: Eine KI mit dem Willen zur Macht? Oder ein Gehirn, das macht, was es will?

Henning Beck, Neurowissenschaftler, Biochemiker und Deutscher Meister im Science Slam, wirft einen spannenden Blick hinter die Kulissen der fehlerhaftesten und innovativsten Struktur überhaupt auf der Welt: dem Gehirn. Er zeigt, was menschliches Denken anders macht als Algorithmen und wie man das nutzen kann, um echte Innovationen zu entwickeln.

Highlights

Netzwerken und weiterbilden

Freuen Sie sich auf eine breite Auswahl praxisnaher Fachvorträge in vier parallelen Vortragsslots und entdecken Sie die begleitende Ausstellung. An insgesamt 42 Ständen präsentieren sich Experten aus den Bereichen Elektronikdesign und -fertigung, Software sowie Zulieferer für die Branche. Zwischen den Ständen laden Stehtische zum Verweilen ein – perfekte Orte für anregende Gespräche und den Aufbau neuer Kontakte. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr berufliches Netzwerk gezielt zu erweitern und sich mit Fachkolleginnen und -kollegen aus der Branche auszutauschen.

3D-Elektronik im Fokus

Für Entwickler von 3D-Elektronik ist es aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Technologien eine besondere Herausforderung, die funktional, fertigungstechnisch und kostenseitig beste Lösung für ihr Projekt auszuwählen. Hierauf gehen am ersten Konferenztag fünf vom FED-Arbeitskreis 3D-Elektronik ausgesuchte Vorträge ein, die sich mit neuen Entwicklungen bei Tools, additiven Fertigungsprozessen und Materialien in der dreidimensionalen Aufbau- und Verbindungstechnik befassen.

Vorträge auch in Englisch

Erstmals bietet die FED-Konferenz mehrere englischsprachige Vorträge an, um internationalen Teilnehmern den Zugang zur Konferenz zu erleichtern. Diese Beiträge sind so im Programm verteilt, dass nicht-deutschsprachige Besucher nahezu durchgängig die Möglichkeit haben, einen Vortrag in englischer Sprache zu hören. Damit öffnet sich die Konferenz noch stärker für den internationalen Austausch und fördert die Vernetzung der europäischen Elektronikbranche über den D-A-CH-Raum hinaus.

Entspannen im UNESCO-Welterbe

Nach dem ersten Konferenztag laden wir Sie zur Führung durch Lübecks Innenstadt ein, ihres Zeichen UNESCO-Welterbe! Nach dem Gang durch verwinkelte mittelalterliche Gassen und imposante Backsteinarchitektur geht es zur Abendveranstaltung ans Wasser: Im Schuppen 9, direkt an der Trave, haben Sie die Gelegenheit, bei leckerem Essen und guter Stimmung den Tag ausklingen zu lassen und gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen.

Mittwoch, 24. September 2025

ab 07:30 **ANMELDUNG AM FED-EMPFANG UND BESUCH DER AUSSTELLUNG**

08:30 **ERÖFFNUNG DER 33. FED-KONFERENZ**
Dieter Müller, Vorstandsvorsitzender des FED

08:45 **KEYNOTE: NICH LANG SNACKEN – MAN MAKEN!**
Manfred Garz

10:00 **KAFFEEPAUSE / NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

	DESIGN	AK 3D ELEKTRONIK UND ADDITIVE FERTIGUNG	FERTIGUNG	MANAGEMENT
10:45	**AFNOR PEC/IEC PAS 2212: Circuit Board Routing Parameters** Christian Maudet Thales Group	**Neue Materialien für die Realisierung von produktbezogenen Prototypen** Michael Mross HARTING	**Herausforderung durch miniaturisierte Bauformen im Lötprozess** Helge Schimanski Fraunhofer ISIT	**PFAS-Verbot – Wie geht es weiter in 2025** Thorsten Leist HTV
11:35	**Design-Herausforderung DDR-Speicher der 4. und 5. Generation** Ralf Brüning Zuken	**Ceramic-based printed electronics using Multi Material Jetting** Robert Johne AMAREA Techn. GmbH	**Fine-Pitch THD and Selective Soldering – A perfect match** Christian Rückert Ersa	**Die EU Right to Repair Initiative – effiziente Fehlerdiagnosemethoden für die Elektronikreparatur** Hermann Reischer Polar instruments
12:10	**PAUSE MIT MITTAGSIMBISS UND BESUCH DER AUSSTELLUNG**			
13:10	**Open-Source-Hardware - Einführung, IP und Lizenzierung** Martin Häuer Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg	**Klassifizierung und Design 3D-gedruckter elektronischer Schaltungen** Rolf Baltes	**Sustainability aspects within pcb manufacturing** Maarten Cauwe imec & Ghent University	**Nachhaltige Basismaterialien, Prozesse und Leiterplatten – wo könnte die Reise hingehen** Jürgen Wolf Würth Electronic
14:00	**Herausforderungen und Chancen als Layoutdienstleister** Igor Kraft Technotron	**Flight Hub Designing and manufacturing in AME** Nikita Rybalka Nano-Dimension	**iBFE R2 – Zuverlässigkeit & Prozesseigenschaften LMP-Legierungen** David Dudek Trainalytics	**Introducing Soluboard a Biodegradable PCB material with a reduced CO2** Steven Driver Jiva Materials
14:35	**PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**			
15:05	**Holistic Electronic Development** Sascha Meyer 8tronix	**Aktuelle Möglichkeiten der 3D-Elektronikentwicklung** Carsten Kindler Altium	**High Mix – Low Volume in der Elektronikfertigung – Erfolg durch Automatisierung** Richard Scheicher BMK GmbH	**Effizienzsteigerung in der Leiterplattenindustrie durch additive Fertigung mit Inkjet-Technologie** Tobias Borgert Lackwerke Peters
15:55	**Advancing IoT System Development with Model-Driven Engineering and DFMA** Wilfried Lepuschitz bee produced	**3D Elektronikdesign** Markus Schiwon FlowCAD	**Größere Flexibilität für EMS durch Lasertechnologie** Florian Roick Smart Rep	**Prediction of PCBs lifetime** Gerald Weis AT&S

16:30 **ENDE DER VORTRÄGE**

16:45 **STADTFÜHRUNG**

19:30 **ABENDVERANSTALTUNG IM SCHUPPEN 9, GROSSER SAAL, AN DER UNTERTRAVE 1A, 23552 LÜBECK**

Donnerstag, 25. September 2025

ab 08:00 **ANMELDUNG AM FED-EMPFANG UND BESUCH DER AUSSTELLUNG**

08:30 **BEGRÜSSUNG**
Dieter Müller, Vorstandsvorsitzender des FED

08:35 **KEYNOTE: KI – MENSCH GEGEN MASCHINE**
Dr. Hennig Beck

10:00 **KAFFEEPAUSE / NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

	DFM	QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT	FERTIGUNG	MANAGEMENT
10:45	**Design to Cost in der PCB(A)- & Elektronik-entwicklung** Markus Biener Zollner Elektronik	**Warum IPC J-STD-001 und nicht IPC A-610** Stefan Hanigk Ariane Group	**Datenintegration & smarte Lieferketten: Risiken runter Kundenbindung hoch** Mario Krause Bender	**Vorteile der Kreislauf-wirtschaft – Best Practise Erfahrungen aus der Elektronikbranche** Sarah Stolz Feinhütte Halsbrücke
11:35	**Sparen Sie 2 Wochen Entwicklungszeit bei jedem neuen Projekt** Martin Borowski Göpel Electronic	**Applications of AI in Industrial X-ray Inspection** Roger Herger maXerial	**Fake-Bauteile – Strategien zur Risikominimierung** Horst Fischer Components at Service	**Kapitalbindung in der EMS-Branche** Markus Renner Perzeptron

12:10 **PAUSE MIT MITTAGSIMBISS UND BESUCH DER AUSSTELLUNG**

13:10	**Überspannung und Avalanche-Energie in Mosfets** Markus Rehm IBR Ingenieurbüro Rehm	**Innovative Prüftechnik für elektronische Geräte – Entwicklung, Fertigung und Einsatz** Jens Maiwald IBE Ermisch	**Materiallogistik von SMD-Bauteilrollen in der Elektronikfertigung** Ronald Düe Otto Künnecke	**Funktioniert moderne Führung auch in der Produktion?** Andreas Blaut EPS Electronic Products & Systems
14:00	**Entwicklung einer Deep-Space-Elektronik für ein optisches Instrument zur Venus-Kartierung** Alexander Fitzner DLR - Weltraumforschung	**Sensorschraubsysteme mit Werkerassistenz – Problemlöser für die Geräte-montage** Andreas Hänisch Prettl Electronics Lübeck	**Optimierung von Baugrup-pendesigns – Fertigungs-gerechte Layouts aus Sicht des Betriebsmittelbaus** Oliver Hagemes RÖSNICK	**Kultur der Mündigkeit – Wie Sie das „Power House" Ihres Unternehmens planen und bauen** Ralf Hasler Lacon Electronic

14:35 **PAUSE FÜR GESPRÄCHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG**

15:05	**Automatic Layout Optimization** Florian Bauer Siemens EDA	**Crucial role of PCBA cleanli-ness for humidity robust-ness of electronics** Rajan Ambat Technical University of Denmark	**Der Wareneingang als wich-tige Prozessgröße für die nachfolgende Produktion** Raphael Podgurski abp Automationssysteme	**Homepage, LinkedIn-Posts & Videos – von KI-basierter Automatisierung bis zu sprechenden Avataren** Jan Hepke JustRelate Group
15:55	**Sensible use of AI in PCB development and manufacturing** Rainer Assfalg Altair Engineering	**Trends in der technischen Sauberkeit** Patrick Brag Fraunhofer IPA	**Fertigungsdaten auswerten – mit KI zu neuen Erkenntnissen** Edgar Linde Innovaforge	**Kundenbindung mit dem Ziel Cross-Selling** Sebastian Unruh Butter and Salt tech marketing

16:30 **ENDE DER VERANSTALTUNG**

Anmeldung und Preise

Frühbucherrabatt 10% bis 21. Juli 2025 (gilt für K1-K3)

Konferenzteilnahme (Preise in EUR)		FED-Mitglied	Nichtmitglied
K1	**Konferenz 1 Tag am Mi, 24.09.2025 inkl. Abendveranstaltung**	690	990
K2	**Konferenz 1 Tag am Do, 25.09.2025**	620	900
K3	**Konferenz 2 Tage, 24. und 25.09.2025 inkl. Abendveranstaltung**	1.180	1.690
K4	**Begleitperson Abendveranstaltung, 24.09.2025 ab 19:30 Uhr**	120	140

Die Preise für die Konferenzteilnahme (K1, K2, K3) sind von der Mehrwertsteuer befreit. Pos. K4 zzgl. 19% MwSt. In den Teilnahmegebühren (K1, K2, K3) sind enthalten: Konferenzteilnahme (Keynotes, Vorträge, Besuch der Fachausstellung), Mittagessen, Pausensnacks, Pausengetränke, Stadtführung Lübeck, K1 und K3 inkl. Abendveranstaltung am 24.09.2025.

Firmenausstellung (Preise in EUR zzgl. MwSt.)		FED-Mitglied	Nichtmitglied
A1	**Aussteller Premium 2 Tage, 24. und 25.09.2025** freie Platzwahl lt. Ausstellerplan, Stand B 3,00 m x T 2,00 m, 2 Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (K3), 1 Tisch, 2 Stühle, Werbepaket (P1, P3, P4)	3.990	5.990
A2	**Aussteller Classic 2 Tage, 24. und 25.09.2025** B 3,00 m x T 2,00 m, 1 Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (K3), 1 Tisch, 2 Stühle	1.990	2.990
A3	**Zusätzlicher Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (gleiche Leistung wie K3)**	890	1.190

Werbe-/Sponsoringleistungen (Preise in EUR zzgl. MwSt.)		FED-Mitglied	Nichtmitglied
P1	**Logo Webseite 33. FED-Konferenz mit Link zur Unternehmenswebsite**	490	650
P3	**Logo Konferenzapp**	490	650
P4	**Logo Plenarveranstaltung**	490	650

Anmeldung und Teilnahmebedingungen unter www.fed-konferenz.de

Tagungsort

Musik- und Kongresshalle Lübeck
Willy-Brandt-Allee 10
D-23554 Lübeck

Übernachtungen
Buchen Sie Ihre Übernachtungen frühzeitig, da die Zimmeranzahl jeweils begrenzt ist.
Buchungslink unter www.fed-konferenz.de/tagungsort/

Kontakt

FED
Fachverband Elektronikdesign
und -fertigung e. V.
Frankfurter Allee 73C
10247 Berlin
Tel. +49 30 340 60 30 50
Fax +49 30 340 60 30 61
www.fed-konferenz.de
konferenz@fed.de